



Standard-Gehäusekomponenten und Kundenbeistellung gut kombiniert

Für einen weltweit führenden Technologieträger im Bereich der industriellen Hochleistungs-Bildverarbeitung hat HEITEC ein kostengünstiges Gehäuse realisiert, das zu einem Großteil aus Standardkomponenten besteht und durch wenige Änderungen vollständig an die Bedürfnisse des Kunden angepasst wurde.

In vielen Bereichen der industriellen Produktion ist während bzw. zwischen einzelnen Produktionsschritten eine optische Prüfung der einzige Weg, die Qualität und damit den vorausgegangenen Produktionsschritt zu überprüfen. So hat sich der Kunde unter anderem auf die Entwicklung und Herstellung von optischen Inspektionssystemen spezialisiert. Die Systeme sind z.B. in der Drucktechnik zur Sicherstellung der geforderten Qualität aber auch bei der Kontrolle von Sicherheitsmerkmalen und multispektralen Spezialdrucken zu finden. Je schneller und qualitativ hochwertiger die Bilderfassung und -verarbeitung ist, umso kürzer sind die Taktraten, mit denen der Endkunde produzieren kann. Um diesem Anspruch gerecht zu werden, schreitet die Entwicklung von immer leistungsfähigeren Kamera- und Inspektionssystemen stetig voran. Daran geknüpft ist natürlich auch der Bedarf nach einer immer leistungsfähigeren Elektronik, welche mit der Verarbeitung und Echtzeit-Auswertung der Daten betraut ist. Nur durch ein hohes Maß an Optimierung und durch ein ausgeklügeltes Hardware-Software-Co-Design

kann der Kunde die in der Inline-Qualitätsinspektion zu erzielenden Durchsatzraten und Messgenauigkeiten erreichen.

Mit der HeiPac Vario-Familie hat sich der Kunde für eine langjährig bewährte und langfristig lieferbare Baugruppenträgerfamilie entschieden. Um die bereits existierenden Elektronikkomponenten sinnvoll in einem Baugruppenträger zu vereinen, fiel die Wahl auf ein 9HE Gehäuse mit der Unterteilung in 7HE und 2HE. Für einen wartungsfreundlichen Zugang ist das Gehäuse mit aufklappbaren 7HE Front- und Rückblenden ausgestattet. Durch die hohe Variabilität der HeiPac Vario-Gehäusefamilie war eine Integration der kundeneigenen Lüftereinheit problemlos umsetzbar. Die Belüftung des Systems erfolgt durch die gelochten Deck- und Bodenbleche von unten nach oben. Das komplette Gehäuse ist EMV-dicht ausgeführt, was spätere Zulassungstests unterstützt und die Gefahr einer zu hohen Störaussendung aber auch die Empfindlichkeit gegenüber Störimpulsen des Systems deutlich minimiert. Das Gehäuse bildet seit Jahren die solide Ausgangsplattform für das Prüfsystem des Kunden und wurde bedingt durch die fortschreitende Entwicklung mehrfach an neue Gegebenheiten angepasst.

ELEKTRONIK

Innovative Gehäuselösung



Ansicht der geschlossenen Front, die in 2HE und 7HE aufgeteilt ist - obere 7HE-Abdeckung ist klappbar



Rückseitige Gehäuse-Ansicht mit kundenspezifischen Aussparungen in den unteren 2HE für individuelle Anwendungen

Technische Kurzbeschreibung

- , Gehäuse HeiPac Vario EMV
- > T x B x H: 465 mm x 84TE x 9HE
- > Integration kundenspezifischer Komponenten
- › Aktive Belüftung vom Boden zum Deckel

Kundenvorteile

- Maßgeschneidertes Gehäuse für kundenspezifisches System
- Unkomplizierte Integration kundenspezifischer Beistellungen
- Zukunftssicher, da jederzeit anpassbar
- Langfristig verfügbar
- Maximaler Bauraum für komplexe Prüf-Elektronik
- Kostenoptimierte 1-Step-Gehäuselösung durch
 Fräsungen und Vormontage bei Heitec

HEITEC AG

Dr.-Otto-Leich-Str. 16 90542 Eckental

Telefon: +49 9126 2934 0
Fax: +49 9126 2934 199
E-Mail: elektronik@heitec.de
Internet: www.heitec-eps.de